

透視美對華芯片管制新變局下的“交易型”遏制戰略

文 | 閔佳昕

特朗普第二任期內，中美科技戰呈現出複雜態勢。前任拜登政府構建的旨在全面封鎖中國獲取先進算力的“小院高牆”（Small Yard, High Fence）體系，在形式上被一種更具個人色彩的“交易型”外交風格所消解。2025年10月起，在“釜山會晤”及隨後達成的“吉隆坡聯合安排”之後，美國政府在表面上推翻了部分嚴苛的管制措施，包括暫停BIS“關聯公司規則（Affiliates Rule）”、批准英偉達向中國出口高性能H200芯片，並正式宣佈結束上屆拜登政府發起的針對中國芯片的貿易調查。然而，透過這些“鬆綁”的表象，我們必須清醒地看到，美國對華科技遏制的本質並未發生根本性逆轉，其戰略重心正從單純的“斷供封鎖”轉向“依賴性鎖定”。

封鎖的極限與反作用

自2018年以來，美國政府試圖構建起一套精密複雜的對華半導體出口管制體系。特別是拜登政府通過不斷修訂《出口管制條例》（EAR），逐步強化“小院高牆”（Small Yard, High Fence）的對華遏制策略；通過“顛覆性技術打擊力量”（Disruptive Technology Strike Force）等機制作為抓手，不斷強化對出口管制違規行為的打擊和震懾；利用“實體清單（Entity List）”、“軍事最終用戶（MEU）清單”以及極具殺傷力的“外國直接產品規則（FDPR）”，試圖在物理層面切斷中國獲取先進計算能力的途徑。

這一戰略雖然一度給中國半導體產業帶來了短期陣痛，但其也

暴露出明顯的局限性與反作用：

首先，技術封鎖陷入困境。儘管美國不斷收緊算力閾值，從A100/H100的全面禁運，到針對H800/A800等“特供版”的補漏，再到對H20等邊緣產品的審查，中國企業展現出了極強的韌性與適應能力。通過架構優化、Chiplet（芯粒）技術、先進封裝等方式，中國AI產業仍在快速發展。更重要的是，封鎖反而倒逼了中國本土芯片產業的爆發。例如，儘管華為坦承單顆芯片性能與英偉達尚有代差，但通過“以群計算補單芯片”的策略，華為在超節點（SuperPoD）規模和互聯技術上實現領先：其九月份發佈的超節點產品在卡規模（最高支持15488卡）、總算

力和互聯帶寬等指標上已具備挑戰甚至超越英偉達未來系統的實力，為國產AI算力提供了一個不依賴外部供應鏈、性能可達實用水準且自主可控的堅實替代方案。

其次，美國本土產業面臨增長壓力。中國不僅是全球最大的半導體市場，更是英偉達、英特爾、AMD等美國芯片巨頭最主要的營收來源地之一。在管制實施前，中國市場貢獻了英偉達數據中心業務約20%-25%的營收。嚴厲的管制導致美國企業失去了這一關鍵市場，進而影響其研發投入能力。英偉達CEO黃仁勳曾多次來華並奔赴華盛頓遊說，警告過度的管制將導致美國失去這一關鍵市場。

“交易型”科技外交

2025年下半年，美國顯著調整了對華科技政策。特朗普2.0時代傾向於通過反復的鬆緊調節，意圖在遏制中國高端突破的同時，榨取最

大化的商業利益。特朗普政府及其核心智囊（如商務部長霍華德·盧特尼克）認為，單純的封鎖不僅未能扼殺中國芯片產業，反而刺激其自主

創新，不如通過傾銷美國技術，讓中國繼續依賴美國的生態系統，同時通過徵收高額“保護費”來反哺美國製造業。